

2024-2030年中国半导体行业 发展趋势与未来发展趋势报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国半导体行业发展趋势与未来发展趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202404/450641.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。

2022年，全球半导体收入增长1.1%，达到6017亿美元，高于2021年的5950亿美元。

当前，我国迎来了半导体产业发展的极佳机遇。2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。在事关国家安全和发展的基础核心领域，《纲要》提到制定实施战略性科学计划和科学工程。其中，集成电路攻关方面，《纲要》重点强调推进集成电路设计工具、中电装备和高纯靶材等关键材料研发、集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等矿禁带半导体发展。2021年3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》，明确了对五类情形免征进口关税，将于2020年7月27日至2030年12月31日实施，意味着《通知》涉及到的商品将享受免征进口关税10年的利好。2021年4月22日，工信部、国家发改委、财政部和国家税务局发布公告，明确了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）第二条中所称国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件。公告自2020年1月1日起实施。自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

在投融资方面，2022年融资事件超680起，规模超1170亿元，相比2021年超1100亿元的融资规模增速明显放缓，但整体热度仍在。从下游市场来看，则是冰火两重天，智能手机出货量预计下降严重，而新能源汽车出货量将高速增长，带动汽车芯片规模扩大，如今汽车缺芯仍非常严重。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国半导体行业发展趋势与未来发展趋势报告》共十七章。首先介绍了半导体行业的总体概况及全球行业发展形势，接着分析了中国半导体行业发展环境、半导体市场总体发展状况。然后分别对半导体产业的产业链相关行业、行业重点企业的经营状况及行业项目案例投资进行了详尽的透析。最后，报告对半导体行业进行了投资分析并对行业未来发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中国海关总署、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对半导体产业链有

个系统深入的了解、或者想投资半导体产业链，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 半导体行业概述

1.1 半导体的定义和分类

1.1.1 半导体的定义

1.1.2 半导体的分类

1.1.3 半导体的应用

1.2 半导体产业链分析

1.2.1 半导体产业链结构

1.2.2 半导体产业链流程

1.2.3 半导体产业链转移

第二章 2021-2023年全球半导体产业发展分析

2.1 2021-2023年全球半导体市场总体分析

2.1.1 市场销售规模

2.1.2 产业研发投入

2.1.3 行业产品结构

2.1.4 区域市场格局

2.1.5 企业营收排名

2.1.6 市场规模预测

2.2 美国半导体市场发展分析

2.2.1 产业发展综述

2.2.2 市场发展规模

2.2.3 市场贸易规模

2.2.4 研发投入情况

2.2.5 产业发展战略

2.2.6 未来发展前景

2.3 韩国半导体市场发展分析

2.3.1 产业发展阶段

2.3.2 产业发展现状

2.3.3 市场发展规模

- 2.3.4 企业规模状况
- 2.3.5 市场贸易规模
- 2.3.6 产业发展规划
- 2.4 日本半导体市场发展分析
 - 2.4.1 行业发展历史
 - 2.4.2 市场发展规模
 - 2.4.3 企业运营情况
 - 2.4.4 市场贸易状况
 - 2.4.5 细分产业状况
 - 2.4.6 行业实施方案
 - 2.4.7 行业发展经验
- 2.5 其他国家
 - 2.5.1 加拿大
 - 2.5.2 英国
 - 2.5.3 法国
 - 2.5.4 德国

第三章 中国半导体产业发展环境分析

- 3.1 中国宏观经济环境分析
 - 3.1.1 宏观经济概况
 - 3.1.2 对外经济分析
 - 3.1.3 固定资产投资
 - 3.1.4 工业运行情况
 - 3.1.5 宏观经济展望
- 3.2 社会环境
 - 3.2.1 移动网络运行状况
 - 3.2.2 电子信息产业增速
 - 3.2.3 电子信息制造业特点
 - 3.2.4 中美科技战的影响
- 3.3 技术环境
 - 3.3.1 研发经费投入增长
 - 3.3.2 摩尔定律发展放缓

3.3.3 产业专利申请状况

第四章 中国半导体产业政策环境分析

4.1 政策体系分析

4.1.1 管理体制

4.1.2 政策汇总

4.1.3 行业标准

4.1.4 政策规划

4.2 重要政策解读

4.2.1 集成电路高质量发展政策原文

4.2.2 集成电路高质量发展政策解读

4.2.3 集成电路产业发展推进纲要解读

4.2.4 集成电路产业发展进口税收政策

4.3 相关政策分析

4.3.1 中国制造支持政策

4.3.2 智能制造发展战略

4.3.3 产业投资基金支持

4.3.4 东数西算政策的影响

4.4 政策发展建议

4.4.1 提高政府专业度

4.4.2 提高企业支持力度

4.4.3 实现集中发展规划

4.4.4 成立专业顾问团队

4.4.5 建立精准补贴政策

第五章 2021-2023年中国半导体产业发展分析

5.1 中国半导体产业发展背景

5.1.1 产业发展历程

5.1.2 产业供需现状

5.1.3 产业链企业业绩

5.1.4 大基金投资规模

5.2 2021-2023年中国半导体市场运行状况

- 5.2.1 产业销售规模
- 5.2.2 产业区域分布
- 5.2.3 相关企业数量
- 5.2.4 国产替代加快
- 5.2.5 市场需求分析
- 5.3 半导体行业财务状况分析
 - 5.3.1 上市公司规模
 - 5.3.2 上市公司分布
 - 5.3.3 经营状况分析
 - 5.3.4 盈利能力分析
 - 5.3.5 营运能力分析
 - 5.3.6 成长能力分析
 - 5.3.7 现金流量分析
- 5.4 半导体行业工艺流程用膜分析
 - 5.4.1 蓝膜晶圆的介绍及用途
 - 5.4.2 晶圆制程保护膜的应用
 - 5.4.3 半导体封装DAF膜介绍
 - 5.4.4 晶圆芯片保护膜的封装需求
 - 5.4.5 氧化物半导体薄膜制备技术
- 5.5 中国半导体产业发展问题分析
 - 5.5.1 产业发展短板
 - 5.5.2 技术发展壁垒
 - 5.5.3 贸易摩擦影响
 - 5.5.4 市场垄断困境
- 5.6 中国半导体产业发展措施建议
 - 5.6.1 产业发展战略
 - 5.6.2 产业发展路径
 - 5.6.3 研发核心技术
 - 5.6.4 人才发展策略
 - 5.6.5 突破垄断策略

第六章 2021-2023年中国半导体行业上游半导体材料发展综述

6.1 半导体材料相关概述

6.1.1 半导体材料基本介绍

6.1.2 半导体材料主要类别

6.1.3 半导体材料产业地位

6.2 2021-2023年全球半导体材料发展状况

6.2.1 市场规模分析

6.2.2 细分市场结构

6.2.3 区域分布状况

6.2.4 市场发展预测

6.3 2021-2023年中国半导体材料行业运行状况

6.3.1 应用环节分析

6.3.2 产业支持政策

6.3.3 市场规模分析

6.3.4 相关专利数量

6.3.5 企业注册数量

6.3.6 企业相关规划

6.3.7 细分市场发展

6.3.8 项目建设动态

6.3.9 国产替代进程

6.4 半导体制造主要材料：硅片

6.4.1 硅片基本简介

6.4.2 硅片生产工艺

6.4.3 行业地位分析

6.4.4 市场发展规模

6.4.5 市场份额分析

6.4.6 市场价格分析

6.4.7 市场竞争状况

6.4.8 市场产能分析

6.4.9 硅片尺寸趋势

6.5 半导体制造主要材料：靶材

6.5.1 靶材基本简介

6.5.2 靶材生产工艺

- 6.5.3 市场发展规模
- 6.5.4 全球市场格局
- 6.5.5 国内市场格局
- 6.5.6 技术发展趋势
- 6.6 半导体制造主要材料：光刻胶
 - 6.6.1 光刻胶基本简介
 - 6.6.2 光刻胶工艺流程
 - 6.6.3 市场规模分析
 - 6.6.4 细分市场结构
 - 6.6.5 各厂商市占率
 - 6.6.6 企业运营情况
 - 6.6.7 行业国产化情况
 - 6.6.8 行业发展瓶颈
- 6.7 其他主要半导体材料市场发展分析
 - 6.7.1 掩膜版
 - 6.7.2 CMP材料
 - 6.7.3 湿电子化学品
 - 6.7.4 电子气体
 - 6.7.5 封装材料
- 6.8 中国半导体材料行业存在的问题及发展对策
 - 6.8.1 行业发展滞后
 - 6.8.2 产品同质化问题
 - 6.8.3 核心技术缺乏
 - 6.8.4 行业发展建议
 - 6.8.5 行业发展思路
- 6.9 半导体材料产业未来发展前景展望
 - 6.9.1 行业发展趋势
 - 6.9.2 行业需求分析
 - 6.9.3 行业前景分析

第七章 2021-2023年中国半导体行业上游半导体设备发展分析

7.1 半导体设备相关概述

- 7.1.1 半导体设备重要作用
- 7.1.2 半导体设备主要种类
- 7.2 全球半导体设备市场发展形势
 - 7.2.1 市场销售规模
 - 7.2.2 市场区域格局
 - 7.2.3 市场份额分析
 - 7.2.4 市场竞争格局
 - 7.2.5 重点厂商介绍
 - 7.2.6 厂商竞争优势
- 7.3 2021-2023年中国半导体设备市场发展现状
 - 7.3.1 市场销售规模
 - 7.3.2 市场需求分析
 - 7.3.3 市场国产化率
 - 7.3.4 行业进口情况
 - 7.3.5 企业研发情况
- 7.4 半导体产业链主要环节核心设备分析
 - 7.4.1 硅片制造设备
 - 7.4.2 晶圆制造设备
 - 7.4.3 封装测试设备
- 7.5 中国半导体设备市场投资机遇分析
 - 7.5.1 行业投资机会分析
 - 7.5.2 行业投资阶段分析
 - 7.5.3 细分市场投资潜力
 - 7.5.4 国产化的投资空间

第八章 2021-2023年中国半导体行业中游集成电路产业分析

- 8.1 2021-2023年中国集成电路产业发展综况
 - 8.1.1 集成电路产业链
 - 8.1.2 产业发展特征
 - 8.1.3 产业销售规模
 - 8.1.4 产品产量规模
 - 8.1.5 市场贸易状况

8.1.6 人才需求规模

8.2 2021-2023年中国IC设计行业发展分析

8.2.1 行业发展历程

8.2.2 市场发展规模

8.2.3 企业发展状况

8.2.4 企业营收排名

8.2.5 产业地域分布

8.2.6 产品领域分布

8.2.7 行业面临挑战

8.3 2021-2023年中国IC制造行业发展分析

8.3.1 晶圆生产工艺

8.3.2 晶圆加工技术

8.3.3 市场发展规模

8.3.4 代工企业营收

8.3.5 行业发展困境

8.3.6 行业发展措施

8.3.7 行业发展目标

8.4 2021-2023年中国IC封装测试行业发展分析

8.4.1 行业概念界定

8.4.2 行业基本特点

8.4.3 行业发展规律

8.4.4 市场发展规模

8.4.5 企业营收排名

8.4.6 核心竞争要素

8.4.7 行业发展趋势

8.5 中国集成电路产业发展思路解析

8.5.1 产业发展建议

8.5.2 产业突破方向

8.5.3 产业创新发展

8.6 集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

8.6.1 全球市场趋势

8.6.2 行业发展机遇

8.6.3 市场发展前景

第九章 2021-2023年其他半导体细分行业发展分析

9.1 传感器行业分析

9.1.1 产业链结构分析

9.1.2 市场发展规模

9.1.3 市场结构分析

9.1.4 区域分布格局

9.1.5 企业数量规模

9.1.6 主要竞争企业

9.1.7 专利申请数量

9.1.8 市场发展态势

9.1.9 行业发展问题

9.1.10 行业发展对策

9.2 分立器件行业分析

9.2.1 行业政策环境

9.2.2 市场销售规模

9.2.3 行业产量规模

9.2.4 功率器件市场

9.2.5 贸易进口规模

9.2.6 市场竞争格局

9.2.7 行业进入壁垒

9.2.8 行业技术水平

9.2.9 行业发展趋势

9.3 光电器件行业分析

9.3.1 行业政策环境

9.3.2 行业产量规模

9.3.3 企业注册数量

9.3.4 专利申请数量

9.3.5 市场融资规模

9.3.6 行业进入壁垒

9.3.7 行业发展策略

9.3.8 行业发展趋势

第十章 2021-2023年中国半导体行业下游应用领域发展分析

10.1 半导体下游终端需求结构

10.2 消费电子

10.2.1 产业发展规模

10.2.2 产业创新成效

10.2.3 投资热点分析

10.2.4 产业发展趋势

10.3 汽车电子

10.3.1 产业相关概述

10.3.2 产业链条结构

10.3.3 市场规模分析

10.3.4 细分市场结构

10.3.5 专利申请状况

10.3.6 企业布局情况

10.3.7 技术发展方向

10.3.8 市场前景预测

10.4 物联网

10.4.1 产业核心地位

10.4.2 产业模式创新

10.4.3 市场支出规模

10.4.4 市场规模分析

10.4.5 产业存在问题

10.4.6 产业发展展望

10.5 创新应用领域

10.5.1 5G芯片应用

10.5.2 人工智能芯片

10.5.3 区块链芯片

第十一章 2021-2023年中国半导体产业区域发展分析

11.1 中国半导体产业区域布局分析

11.2 长三角地区半导体产业发展分析

11.2.1 区域市场发展形势

11.2.2 技术创新发展路径

11.2.3 上海产业发展状况

11.2.4 浙江产业发展情况

11.2.5 江苏产业发展规模

11.2.6 安徽产业发展综况

11.3 京津冀区域半导体产业发展分析

11.3.1 区域产业发展概况

11.3.2 北京产业发展状况

11.3.3 天津推进产业发展

11.3.4 河北产业发展综况

11.4 珠三角地区半导体产业发展分析

11.4.1 广东产业发展状况

11.4.2 深圳产业发展分析

11.4.3 广州产业发展情况

11.4.4 珠海产业发展综况

11.5 中西部地区半导体产业发展分析

11.5.1 四川产业发展综况

11.5.2 成都产业发展综况

11.5.3 湖北产业发展综况

11.5.4 武汉产业发展综况

11.5.5 重庆产业发展综况

11.5.6 陕西产业发展综况

第十二章 2021-2023年国外半导体产业重点企业经营分析

12.1 三星电子（Samsung Electronics）

12.1.1 企业发展概况

12.1.2 企业经营状况

12.1.3 企业研发动态

12.1.4 企业投资计划

12.2 英特尔（Intel）

- 12.2.1 企业发展概况
- 12.2.2 企业经营状况
- 12.2.3 企业研发动态
- 12.2.4 资本市场布局
- 12.3 SK海力士（SK hynix）
 - 12.3.1 企业发展概况
 - 12.3.2 企业经营状况
 - 12.3.3 企业研发布局
 - 12.3.4 项目建设动态
 - 12.3.5 对华战略分析
- 12.4 美光科技（Micron Technology）
 - 12.4.1 企业发展概况
 - 12.4.2 企业经营状况
 - 12.4.3 业务运营布局
 - 12.4.4 企业竞争优势
 - 12.4.5 企业项目布局
- 12.5 高通公司（QUALCOMM, Inc.）
 - 12.5.1 企业发展概况
 - 12.5.2 企业经营状况
 - 12.5.3 商业模式分析
 - 12.5.4 业务运营状况
 - 12.5.5 企业研发动态
- 12.6 博通公司（Broadcom Limited）
 - 12.6.1 企业发展概况
 - 12.6.2 企业经营状况
 - 12.6.3 研发合作动态
 - 12.6.4 产业布局方向
- 12.7 德州仪器（Texas Instruments）
 - 12.7.1 企业发展概况
 - 12.7.2 企业经营状况
 - 12.7.3 产业业务布局
 - 12.7.4 产品研发动态

12.7.5 企业发展战略

12.8 西部数据（Western Digital Corp.）

12.8.1 企业发展概况

12.8.2 企业经营状况

12.8.3 企业竞争分析

12.8.4 项目发展动态

12.9 恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）

12.9.1 企业发展概况

12.9.2 企业经营状况

12.9.3 企业发展战略

12.9.4 项目发展动态

第十三章 2020-2023年中国半导体产业重点企业经营分析

13.1 华为海思

13.1.1 企业发展概况

13.1.2 企业经营状况

13.1.3 企业研发进展

13.1.4 未来发展布局

13.2 紫光展锐

13.2.1 企业发展概况

13.2.2 企业经营状况

13.2.3 企业发展成就

13.2.4 产品研发动态

13.3 中兴微电子

13.3.1 企业发展概况

13.3.2 研发实力分析

13.3.3 企业发展历程

13.3.4 企业经营状况

13.3.5 企业发展战略

13.4 杭州士兰微电子股份有限公司

13.4.1 企业发展概况

13.4.2 经营效益分析

- 13.4.3 业务经营分析
- 13.4.4 财务状况分析
- 13.4.5 核心竞争力分析
- 13.4.6 公司发展战略
- 13.5 台湾积体电路制造公司
 - 13.5.1 企业发展概况
 - 13.5.2 企业经营状况
 - 13.5.3 项目投资布局
 - 13.5.4 资本开支计划
- 13.6 中芯国际集成电路制造有限公司
 - 13.6.1 企业发展概况
 - 13.6.2 经营效益分析
 - 13.6.3 业务经营分析
 - 13.6.4 财务状况分析
 - 13.6.5 核心竞争力分析
 - 13.6.6 公司发展战略
 - 13.6.7 未来前景展望
- 13.7 华虹半导体
 - 13.7.1 企业发展概况
 - 13.7.2 业务发展范围
 - 13.7.3 企业发展实力
 - 13.7.4 企业经营状况
 - 13.7.5 项目投资进展
- 13.8 华大半导体
 - 13.8.1 企业发展概况
 - 13.8.2 主营产品分析
 - 13.8.3 企业布局分析
 - 13.8.4 体系认证动态
 - 13.8.5 产品研发动态
- 13.9 江苏长电科技股份有限公司
 - 13.9.1 企业发展概况
 - 13.9.2 经营效益分析

- 13.9.3 业务经营分析
- 13.9.4 财务状况分析
- 13.9.5 核心竞争力分析
- 13.9.6 公司发展战略
- 13.9.7 未来前景展望
- 13.10 北方华创科技集团股份有限公司
- 13.10.1 企业发展概况
- 13.10.2 经营效益分析
- 13.10.3 业务经营分析
- 13.10.4 财务状况分析
- 13.10.5 核心竞争力分析
- 13.10.6 未来前景展望

第十四章 中国半导体行业产业链项目投资案例深度解析

- 14.1 半导体硅片之生产线项目
- 14.1.1 募集资金计划
- 14.1.2 项目基本概况
- 14.1.3 项目投资价值
- 14.1.4 项目投资可行性
- 14.1.5 项目投资影响
- 14.2 高端集成电路装备研发及产业化项目
- 14.2.1 项目基本概况
- 14.2.2 项目实施价值
- 14.2.3 项目建设基础
- 14.2.4 项目市场前景
- 14.2.5 项目实施进度
- 14.2.6 资金需求测算
- 14.2.7 项目经济效益
- 14.3 大尺寸再生晶圆半导体项目
- 14.3.1 项目基本概况
- 14.3.2 项目建设基础
- 14.3.3 项目实施价值

- 14.3.4 资金需求测算
- 14.3.5 项目经济效益
- 14.4 LED芯片生产基地建设项目
 - 14.4.1 项目基本情况
 - 14.4.2 项目投资意义
 - 14.4.3 项目投资可行性
 - 14.4.4 项目实施主体
 - 14.4.5 项目投资计划
 - 14.4.6 项目收益测算
 - 14.4.7 项目实施进度

第十五章 对半导体产业投资热点及价值综合评估

- 15.1 半导体产业并购状况分析
 - 15.1.1 全球并购规模分析
 - 15.1.2 国际企业并购事件
 - 15.1.3 国内企业并购事件
 - 15.1.4 半导体并购审查力度
 - 15.1.5 国内并购趋势预测
 - 15.1.6 市场并购应对策略
- 15.2 半导体产业投融资状况分析
 - 15.2.1 融资规模数量
 - 15.2.2 热点融资领域
 - 15.2.3 上市企业数量
 - 15.2.4 重点融资事件
 - 15.2.5 产业链投资机会
- 15.3 对半导体产业进入壁垒评估
 - 15.3.1 技术壁垒
 - 15.3.2 资金壁垒
 - 15.3.3 人才壁垒
- 15.4 对集成电路产业投资价值评估及投资建议
 - 15.4.1 投资价值综合评估
 - 15.4.2 市场机会矩阵分析

- 15.4.3 产业进入时机分析
- 15.4.4 产业投资风险剖析
- 15.4.5 产业投资策略建议

第十六章 中国半导体行业上市公司资本布局分析

- 16.1 对中国半导体行业投资指数分析
 - 16.1.1 投资项目数量
 - 16.1.2 投资金额分析
 - 16.1.3 项目均价分析
- 16.2 对中国半导体行业资本流向统计分析
 - 16.2.1 投资流向统计
 - 16.2.2 投资来源统计
 - 16.2.3 投资进出平衡状况
- 16.3 A股及新三板上市公司在半导体行业投资动态分析
 - 16.3.1 投资项目综述
 - 16.3.2 投资区域分布
 - 16.3.3 投资模式分析
 - 16.3.4 典型投资案例
- 16.4 对中国半导体行业上市公司投资排行及分布状况
 - 16.4.1 企业投资排名
 - 16.4.2 企业投资分布
- 16.5 对中国半导体行业重点投资标的投融资项目推介
 - 16.5.1 宏微科技
 - 16.5.2 钜泉科技
 - 16.5.3 恒烁股份

第十七章 对2024-2030年中国半导体产业发展前景及趋势预测分析

- 17.1 中国半导体产业整体发展前景展望
 - 17.1.1 技术发展利好
 - 17.1.2 行业发展机遇
 - 17.1.3 进口替代良机
 - 17.1.4 发展趋势向好

- 17.1.5 行业发展预测
- 17.2 “十四五”中国半导体产业链发展前景
 - 17.2.1 产业上游发展前景
 - 17.2.2 产业中游发展前景
 - 17.2.3 产业下游发展前景
- 17.3 对2024-2030年中国半导体产业预测分析
 - 17.3.1 2024-2030年中国半导体产业影响因素分析
 - 17.3.2 2023-2027年全球半导体销售额预测
 - 17.3.3 2024-2030年中国半导体销售额预测
 - 17.3.4 2024-2030年中国集成电路行业销售额预测
 - 17.3.5 2024-2030年中国封装测试业销售额预测
 - 17.3.6 2024-2030年中国IC制造业销售额预测

图表目录

- 图表 半导体分类结构图
- 图表 半导体分类
- 图表 半导体分类及应用
- 图表 半导体产业链示意图
- 图表 半导体上下游产业链
- 图表 半导体产业转移和产业分工
- 图表 集成电路产业转移状况
- 图表 全球主要半导体厂商
- 图表 1996-2021年全球半导体月度收入及增速
- 图表 2015-2021年全球半导体市场销售总额
- 图表 2011、2021年全球分区域半导体研发总支出
- 图表 2021年全球半导体主要产品销售结构
- 图表 2021年全球半导体厂商营收排名
- 图表 2015-2021年美国半导体市场规模
- 图表 2021年美国半导体出口商品TOP5
- 图表 2001-2021年美国半导体产业研发支出和设备支出在销售额中占比
- 图表 美国半导体产业研发投入率在美国本土科技产业中排名
- 图表 日本半导体产业发展历程

图表 2017-2022年日本半导体设备出货额

图表 2021年日本半导体企业销售额排行榜

图表 2010-2021年日本半导体相关出口额

图表 半导体企业经营模式发展历程

图表 IDM商业模式

图表 Fabless+Foundry模式

图表 2018-2022年国内生产总值及其增长速度

图表 2018-2022年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表 2018-2022年货物进出口总额

图表 2022年货物进出口总额及其增长速度

图表 2022年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表 2022年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表 2022年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重

图表 2022年外商直接投资及其增长速度

图表 2022年对外非金融类直接投资额及其增长速度

图表 2021年全国三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

图表 2021年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表 2021年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表 2022年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

图表 2022年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

图表 2022年固定资产投资新增主要生产与运营能力

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202404/450641.html>